



週間半導体ニュース

2026年9月14日 – 9月20日

AIメモリー逼迫、データセンター規制強化、自動運転のアジア展開が今週の焦点

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J

情報源: Bloomberg, Reuters, CNBC, TechCrunch, DigiTimes ほか

エディターズ・ピック



月25万枚

サムスン、 HBM4を倍増へ

サムスはHBM生産能力を2027年までに約4割増の月25万枚に拡大し、HBM4出荷を前年比で倍増させる計画。 ([Seoul Economic Daily](#)、9/20)



2027年

Waymo、東京 進出を発表

Waymoは日本交通・GOと提携し、2027年に東京で自動運転タクシーを商用化へ。アジアでは初の展開となる。 ([Yahoo Autos/Bloomberg](#)、9/14-16)



417対3

米下院、電気料 金転嫁抑制法を 可決

出力100MW超のデータセンターに送電網増強費用を負担させる法案が超党派で下院を通過した。 ([Tech Times](#)、9/17)

1. AIチップ・GPU

ファーウェイ、Ascend 960ロードマップを発表

ファーウェイ・コネクテッド2026で、光近接パッケージング(NPO)を業界で初採用したとする「Ascend 960」スーパーノードを公開。最大10兆パラメータのモデル学習・推論に対応する。訓練・推論分離型の960DTも2027年第1四半期に前倒し投入する計画。 ([DigiTimes](#)、9/17)

Axelera AI、推論プロセッサ「Europa」を発売

欧州のAIチップ新興企業が、GPU比で電力効率6倍を謳う推論用AIPU「Europa」を発売。デルやSupermicroが対応システムを提供し、販売パイプラインは15億ドル超、防衛・ロボティクス分野で600社超の顧客を持つ。 ([Axelera AI](#)、9/15)

グーグルTPU、投資回収は1年未満

グーグルクラウドのクリアンCEOは、TPU搭載サーバーの投資回収期間が1年未満で全体平均の半分程度と明らかにした。DigiTimesは、ASIC設計を担うメディアテックとブロードCOMの業績上振れ余地は大きいと指摘する。 ([DigiTimes](#)、9/14)

2. 製造・サプライチェーン

TSMC、2nm・3nm能力を増強

2026年末~2027年半ばに2nm能力を22%、3nmを16%超増強。先端パッケージングCoWoS能力も2028年までに倍増させ、台湾・アリゾナ・日本に3nm工場3カ所を新設する。

(TrendForce、9/14)

サムスン、HBM4生産能力をほぼ倍増へ

HBM総生産能力を現在の月18万枚から約4割増の25万枚に拡大し、HBM4/HBM4Eの出荷を前年比で倍増させる計画。出荷構成に占めるHBM4系比率は現在の4割から8割に高まる見通し。

(Seoul Economic Daily、9/20)

SKハイニックス、インテルとオハイオ州生産で協議

インテルの遅延中オハイオ工場の能力を借りる案と、インテル・クラウド顧客との合併案の2通りで、米国内AI向けメモリー生産を協議中と報じられた。両社株価は報道を受け上昇、米メモリー大手マイクロンの国内優位性が揺らぐ可能性がある。 (Reuters via Benzinga、9/16-

17)

3. コンシューマー向けチップ

メディアテック、初の2nmフラッグシップを発表

「Dimensity 9600 Pro」は2+3+3構成の全ビッグコア設計を採用し、前世代比でシングルコア性能17%向上、マルチコア消費電力61%削減を実現。最大300億パラメータのオンデバイスAIに対応するデュアルNPUを搭載する。 ([MediaTek、9/15](#))

メディアテックとVivo、300億パラメータAIをスマホに搭載

Dimensity 9600 Proをいち早く採用したVivoは、独自ソフトウェアスタックで最大300億パラメータのMoEモデルをオンデバイス実行可能にした。2026年のフラッグシップ競争は「エージェント型AI」が中心となり、クアルコムとの競合が激化している。 ([DigiTimes、9/19](#))

4. データセンター・エネルギー

米下院、電気料金転嫁抑制法を417対3で可決

100MW超のデータセンターに送電網増強費用を負担させる「Ratepayer Protection Act」(H.R.9340)が9月16日、超党派で下院通過。電力消費は全米の4.4%、2028年には最大12%に達する見通し。 ([Tech Times](#)、9/17)

ジェネラック、アマゾンと最大80億ドルの発電機供給契約

アマゾンのハイパースケールデータセンター向けに24億ドルの初期契約を締結、将来受注は最大80億ドルに達する可能性。アマゾンは対価として新株予約権を取得し、ジェネラックは商工業部門の人員を1年以内に3千人超へ増強する計画。 ([24/7 Wall St.](#)、9/17)

サンフランシスコ市、45日間の新設凍結を提案

市監督委員会は、2001年以来改定のない建築基準や環境負荷への懸念から、新規承認を最長220日間凍結する条例案を提出。リッチモンド・オークランド両市でも同様の動きが準備されている。 ([KQED](#)、9/15)

5. 自動運転・車載半導体

Waymo、2027年に東京で自動運転タクシー開始へ

日本交通と配車アプリ「GO」との提携により、アジアでは初となる商用展開を東京で実施すると発表。当初は約100台規模での段階的な展開を目指す。ミュンヘンでも2027年後半に展開予定。 ([Yahoo Autos/Bloomberg](#)、9/14-16)

ルーシッド、Boltと欧州でNVIDIA搭載ロボタクシー展開へ

ルーシッド・モーターズは欧州モビリティ企業Boltと提携し、NVIDIAの「Hyperion」自動運転アーキテクチャ採用車両を欧州展開すると発表。Boltは当初2.5万台、2035年までに10万台の完全自動運転車を目標とするが、正式受注や時期は未定。 ([TechCrunch](#)、9/17)

Pony.ai、GACと第4世代自動運転トラックを公開

IAAハノーバーで、GAC商用車のEVプラットフォームを基盤にレベル4自動運転トラックを発表。ロボタクシーと同じ自動運転ドメインコントローラーを採用し、前世代比で部品コストを70%削減。2026年内に量産を開始する。 ([PR Newswire](#)、9/14)

6. チップ新興企業・ベンチャー

Cornelis Networks 2.05億ドル

GPU遊休時間を削減するオープンファブリック技術に調達。 ([TechCrunch](#)、9/14)

Euclyd 2億ユーロ超

元ASML CEOが会長就任。サムスンでテストチップ段階に到達。 ([Tech Startups](#)、9/15)

Altera 20億ドル超(IPO)

インテル系FPGA大手が米上場を非公開申請。 ([Bloomberg](#)、9/15)

Positron AI 8.75億ドル(評価額50億ドル)

HBM不使用の推論チップ「Asimov」を展開中。 ([StorageNewsletter](#)、9/16)

EVAS Intelligence 2.95億ドル

北京拠点のRISC-V新興、米輸出規制の枠外で設計されたアーキテクチャ。 ([Tech Times](#)、9/20)

7. 業界再編・政策

米商務省、Anderonに最大10億ドルのCHIPS助成金を確定

量子半導体向け300mmファウンドリを構築するIBM子会社への助成。IBM自身も同規模を投資するとされる。 ([NIST、9/16](#))

インフィニオン、NOR・F-RAM事業をウィンボンドに11.2億ドルで売却

コア半導体事業への資本集中を狙い、2027年後半の完了を見込む。
([SemiEngineering](#))

インド、135億ドルの「半導体ミッション2.0」を発表

モディ首相がSEMICON India 2026で発表。設計から先端パッケージングまで網羅、12件の製造プロジェクトを承認、うち3件が商業生産を開始。 ([BusinessToday、9/17](#))

日米、米国内半導体工場の建設を関税交渉の一環で協議か

日経アジアによると、グローバルファウンドリーズが運営主体となる可能性のある工場建設が協議されている。金額・時期は未公表。 ([Nikkei Asia via SemiEngineering](#))

関税・州政策ウォッチ

ニューサム州知事、AI「キルスイッチ」構築を加速する行政命令に署名

9月18日、カリフォルニア州はSB813(独立検証機関の枠組み)とAB1405(AI監査人の州登録制度、9月9日成立済み)の実施を前倒しする行政命令に署名し、フロンティアAI企業に独立検証機関による定期監査を義務付ける方針を発表。検証可能なAI「キルスイッチ」の開発を推進し、「制御喪失」事案の定義に「Hugging Face attack」と呼ばれる事案を追加した。ニューサム氏は連邦議会とトランプ大統領に同州の枠組みを国の基準として採用するよう求めた。
(gov.ca.gov、9/18)

関税ウォッチ: 半導体・製造装置を対象とする通商拡大法232条の新たな措置は今週確認されず。現行の25%関税枠組みが継続。



情報源

Bloomberg, Reuters(経由: Benzinga, Investing.com), CNBC, TechCrunch, DigiTimes, TrendForce, Seoul Economic Daily, Tech Times, SemiEngineering, BusinessToday, Texas Tribune, KQED, 24/7 Wall St., PR Newswire, Tech Startups, StorageNewsletter, NIST/米商務省, gov.ca.gov ほか。

全記事URLと詳細な出典一覧は、同時発行のMarkdown版ダイジェストに掲載。

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J